（上接93版）

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，发行价格为44.56元/股，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用人民币12,516.43万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币160,477.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟投入募集资金金额
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.32	75,185.06
2	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	28,166.56
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	16,400.68
合计		128,336.42	119,752.30

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为40,724.78万元。

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》第十五条中的相关规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”

公司在募投项目的实施期间，存在需要使用自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续再以募集资金进行等额置换的情况，主要原因如下：

1、由于公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。

2、公司募投项目的实施期间，存在需要使用自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续再以募集资金进行等额置换的情况，主要原因如下：

1、在募投项目实施过程中需要支付募投项目人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。

2、公司募投项目的实施期间，存在需要使用自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续再以募集资金进行等额置换的情况，主要原因如下：

1、由于公司募投项目在实施过程中需要支付募投项目人员工资、相应社会保险及住房公积金、奖金、补贴等人员薪酬及各项税费，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定及税务机关、社会保险及住房公积金等有关部门的要求，人员薪酬及各项税费的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户统一划转。因此，公司不能通过募集资金专户直接支付前述款项。

2、公司募投项目的实施期间，存在需要使用自有资金等方式支付募投项目部分款项，后续再以募集资金进行等额置换的情况，主要原因如下：

1、根据募投项目的实施情况，由公司相关部门提出付款申请，履行公司内部审批程序。公司财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金先行进行款项支付；

2、公司财务部门建立明细台账，按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表，在以自有资金支付后6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，定期将以自有资金先行支付的募投项目所需资金，从募集资金专户等额转入公司及相关募投项目实施主体基本存款账户或一般存款账户；

3、保荐人对公司及相关募投项目实施主体使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权采取定期或不定期现场核查、书面问询等方式行使监督权，公司及相关募投项目实施主体和存放募集资金的银行应当配合保荐人的核查与问询。

五、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换对公司的影响

公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司运营管理效率和募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

六、公司已履行的审议程序

公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要先行使用自有资金支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，已经公司董事会审议通过，审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

综上所述，保荐人对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688797　证券简称：臻宝科技　公告编号：2026-006

重庆臻宝科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金33,542.35万元和预先支付的发行费用1,441.29万元（不含增值税）。上述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，发行价为人民币44.56元/股，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用（不含税）人民币12,516.43万元，募集资金净额为人民币160,477.08万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《臻宝科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.32	75,185.06
2	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	28,166.56
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	16,400.68
合计		128,336.42	119,752.30

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为40,724.78万元。

根据《招股说明书》，在本次募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行前期投入；待募集资金到位后，公司将用募集资金置换前期投入该等项目的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用情况及置换安排

（一）自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

为保障募投项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2026年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币33,542.35万元，本次拟使用募集资金人民币33,542.35万元置换预先投入募投项目的投资，具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	本次置换金额
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	75,185.06	25,281.14	25,281.14
2	臻宝科技研发中心建设项目	28,166.56	4,727.78	4,727.78
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	16,400.68	3,533.42	3,533.42
合计		119,752.30	33,542.35	33,542.35

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况及置换安排

公司本次发行的各项发行费用合计人民币12,516.43万元（不含增值税），截至2026年6月30日，公司已使用自筹资金预先支付发行费用金额为人民币1,441.29万元（不含增值税），本次拟使用募集资金人民币1,441.29万元置换已支付发行费用的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	以自筹资金已支付金额（不含增值税）	本次置换金额
1	承销及保荐费	377.36	377.36
2	审计及验资费	849.06	849.06
3	律师费	198.11	198.11
4	用于本次发行的信息披露费	–	–
5	发行手续费及其他费用	16.76	16.76
合计		1,441.29	1,441.29

四、公司履行的审议程序

公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币33,542.35万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，同意使用募集资金人民币1,441.29万元（不含增值税）用于置换已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。该事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，本次募集资金置换已履行了必要的审议程序。本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，不会影响募集资金投资项目的正常开展，上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。

综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

六、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，臻宝科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》（上证发〔2026〕45号）的规定，如实反映了臻宝科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688797　证券简称：臻宝科技　公告编号：2026-007

重庆臻宝科技股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 超额募集资金金额及使用用途

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“臻宝科技”）全资子公司武汉臻宝半导体科技有限公司（以下简称“武汉臻宝”）拟使用超募资金人民币25,000万元投资新建“半导体零部件研发生产基地项目”。

● 公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了同意的核查意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

● 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

● 相关风险提示：本项目实施过程中可能存在宏观政策、市场环境、团队建设、项目进度等方面的不确定性风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

一、募集资金基本情况

发行名称	首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市
募集资金总额	172,993.51万元
募集资金净额	160,477.08万元
超募资金金额	40,724.78万元
募集资金到账时间	2026年6月18日

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、超募资金使用安排

超募资金金额	40,724.78万元
前次已使用金额	0万元
本次使用用途及金额	√新项目，半导体零部件研发生产基地项目，项目投资总额52,000万元，其中拟使用超募资金投入金额为25,000万元

1、项目基本情况

新建项目名称	半导体零部件研发生产基地项目
实施主体	武汉臻宝半导体科技有限公司（臻宝科技全资子公司）
实施地点	武汉东湖新技术开发区
项目内容	本项目将围绕碳化硅原材料和零部件、高纯硅精密零部件、氮化铝陶瓷材料和零部件几大核心方向进行建设。
项目总投资金额	52,000.00万元
投资建设周期	3年

2、项目必要性分析

（1）保障国内半导体产业链供应链安全，落实国家自主可控战略

当前，集成电路产业先进制程非金属核心零部件本土供给能力仍不足，部分高精密耗材、功能性陶瓷零部件仍依赖境外厂商供给。受外部环境持续收紧影响，海外厂商在设备维保、零部件供货、技术服务等方面存在显著的不确定性，供应链中断风险直接威胁国内先进制程产线的稳定量产。

随着国内头部晶圆制造基地产能持续扩容，产线对高精密零部件耗材的需求量同步激增，必须同步培育规模化本土零部件配套产能，以强化国内供应链纵深，降低对境外来源供给的依赖。本次通过武汉臻宝新建“半导体零部件研发生产基地项目”可大幅提升高精密零部件本土供给规模，有效填充高端耗材零部件产能缺口，是构建安全可控的集成电路供应链体系的必要产业配套布局。

（2）匹配核心客户产能扩张节奏，破解公司现有产能瓶颈

未来几年，国内主要晶圆制造企业的先进工艺产线将持续扩产，分批次落地大容量新建晶圆产线，叠加存量产线工艺升级改造需求，一方面带来新增设备配套耗材增量，另一方面存量产线持续产生耗材替换需求，形成“增量+存量”的双重市场空间，零部件年度采购需求同比大幅增长。

公司现有生产基地已达设计产能上限，长期处于满产甚至超负荷运行状态，新增配套订单无法完全承接，存在订单延期交付、市场份额流失、错失本轮扩产景气周期的经营风险。本次通过武汉臻宝新建“半导体零部件研发生产基地项目”，可快速释放规模化产能，足额匹配客户中长期耗材采购增量，巩固公司在核心零部件细分赛道的头部地位。

（3）缩短配套服务半径，深度绑定客户

原有生产基地与武汉晶圆制造集群存在跨区域物流成本偏高、客户响应效率不足等短板，样品送样、技术支持等环节周期较长。武汉子公司近距离配套下游核心制造客户产线，可大幅缩短样品交付、技术支持及验证周期；同时削减长途运输成本，规模生产后可有效摊薄单位制造成本，提升产品综合竞争力。

就近配套还可深度参与客户新工艺前置研发，高效响应客户工艺迭代中的定制化需求，同步迭代零部件产品方案，从而加深上下游协同绑定，构筑区位配套壁垒，实现从产品供应向技术协同的关系升级。

3、项目可行性分析

（1）政策与产业区位可行性

本项目落地武汉半导体产业集聚片区，契合国家集成电路关键零部件自主可控顶层规划方向，匹配湖北省、武汉市针对半导体产业发展的专项扶持政策。国内先进制程芯片制造基地持续加码产能扩建，本土晶圆制造端对精密腔体、硅/石英/碳化硅/陶瓷零部件、真空气控零部件的需求持续放大。武汉本地已形成较为完整的晶圆制造、设备整机、配套材料产业集群，区域可提供洁净厂房配套、专业人才支撑、上下游协同等多维营商环境支持，产业协同、生产要素配套、物流交通条件成熟，具备建厂落地的硬性政策与区位基础。

臻宝科技深耕集成电路设备核心零部件多年，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积等前道工艺专用硬脆材料零部件，已完成国内主流晶圆制造企业多轮工艺验证及批量供货，技术路线与下游产线工艺高度匹配，不存在跨工艺适配壁垒。公司产品已批量应用于先进逻辑工艺、3D NAND闪存及DRAM先进工艺存储芯片制造等领域。本次通过全资子公司武汉臻宝，贴近核心制造客户布局生产基地，落地可行性充分。

（2）市场与客户落地可行性

国内头部晶圆制造基地正分阶段释放大容量新增晶圆产能，现有零部件厂商交付缺口持续扩大，客户端具备本土供应商同步扩产配套起其产能增长的诉求，具备稳定、长期订单底盘支撑。现阶段公司现有生产基地产能已满载，订单排产周期拉长，承接客户新增扩产配套需求存在瓶颈，供需缺口形成明确的市场增量空间。

本项目产品聚焦先进制程产线高损耗核心零部件，耗材类核心部件需求具备持续性、重复性；下游客户同步推进多工艺节点迭代，对高精度、高耐蚀定制化零部件增量需求持续释放。本项目建成后可辐射湖北当地及周边客户，缩短物流周期、快速响应客户工艺调试、样品迭代的需求，大幅提升客户粘性与份额拓展能力。项目依托存量成熟认证客户资源，无需从零开展客户导入，市场转化周期短，订单消化具备较高的确定性。

（3）技术与运营实施可行性

技术层面，公司已搭建覆盖原材料制造、精密加工及高性能表面处理全流程工艺体系，拥有核心专利及工艺标准库，核心研发、工艺、品控团队可有力支撑武汉臻宝产线搭建。半导体零部件生产工艺对产品一致性要求极高，公司在新产线良率爬坡方面已积累成熟经验可迁移，不存在核心技术卡壳的风险。

运营层面，武汉产业园区配套洁净车间、化学品、电子级气体、特种废气处理、危废处置等半导体专用基础设施，要素保障较强；本地具备材料制备、精密加工及刻蚀处理等领域的产业工人供给，便于搭建本地化生产团队；并且母公司可统一实施供应链采购、研发赋能、客户协同管理，异地子公司运营管控体系成熟，可有效保障快速量产交付。

4、项目投资概算

本项目计划投资总额为52,000万元，其中拟使用超募资金投入金额25,000万元，资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用超募资金金额	投资占比
1	工程建设费用	46,017.60	25,000.00	88.50%
1.1	土地购置费	1,236.60	0.00	2.38%
1.2	场地建造及装修费	9,146.00	9,146.00	17.59%
1.3	工程建造其他费用	595.00	595.00	1.14%
1.4	硬件购置费	35,040.00	15,259.00	67.38%
2	研发费用	3,832.93	0.00	7.37%
3	基本预备费2%	997.02	0.00	1.92%
4	铺底流动资金	1,152.45	0.00	2.22%
合计		52,000.00	25,000.00	100.00%

本项目投资建设期为3年，拟利用公司已有的产业化成果、技术优势和成熟经验，促进本项目的高效实施。项目建成后将有效突破公司现有产能瓶颈，加强湖北及周边地区核心客户的产能配套与高效协同响应能力，进一步缩短交付周期、提升服务品质。本项目契合公司以客户为中心的战略定位，有助于巩固公司在核心零部件细分领域的市场地位，提升公司整体核心竞争力。

5、项目主要风险分析

（1）技术与客户验证风险

半导体核心零部件验证周期长达数月至数年，新建产线所生产零部件需重新导入客户验证，若新建产线产品一致性表现、性能参数、耐蚀性能未达客户严苛工艺标准，将无法批量导入，导致新建产能闲置进而压缩盈利空间。

（2）项目进程及效益不达预期的风险

公司现有产能长期处于满负荷运行状态，扩产是应对订单增长的必然选择，但产能快速扩张也伴随一定的经营压力。若新建产能无法在预期时间内实现满产，新增的人力成本、设备折旧及厂房运维费用将对企业阶段性财务表现形成压力。敬请广大投资者关注市场增速或客户扩产节奏不及预期导致产能闲置的风险。

（3）项目备案、审批风险

本项目实施需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止甚至终止的风险。

6、保障超募资金安全的措施

本项目相关审批程序履行完成后，公司将开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金，并与保荐人和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，公司将根据新建项目的实施进度，逐步投入募集资金并对项目实施单独建账核算。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定使用和管理募集资金，并严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、适用的审议程序及保荐人意见

（一）履行的审议程序

公司于2026年8月6日召开了第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。独立董事专门会议认为公司本次使用部分超募资金投资建设新项目，有利于提高超募资金使用效率，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。此外，公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分超募资金投资建设新项目事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定要求。

综上，保荐人对公司使用部分超募资金投资建设新项目事宜无异议。

特此公告。

重庆臻宝科技股份有限公司董事会

2026年8月8日

证券代码：688797　证券简称：臻宝科技　公告编号：2026-008

重庆臻宝科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金向全资子公司武汉臻宝半导体科技有限公司（以下简称“武汉臻宝”）提供总额不超过25,000万元的无息借款，用以实施公司超募资金所投资建设的新项目“半导体零部件研发生产基地项目”（以下简称“超募项目”）。公司保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。公司现将相关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，每股发行价格为人民币44.56元，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,516.43万元，实际募集资金净额为人民币160,477.08万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具天健验〔2026〕8-5号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、超募资金使用安排

超募资金金额	40,724.78万元
前次已使用金额	0万元
本次使用用途及金额	√新项目，半导体零部件研发生产基地项目，项目投资总额52,000万元，其中拟使用超募资金投入金额为25,000万元

1、项目基本情况

新建项目名称	半导体零部件研发生产基地项目
实施主体	武汉臻宝半导体科技有限公司（臻宝科技全资子公司）
实施地点	武汉东湖新技术开发区
项目内容	本项目将围绕碳化硅原材料和零部件、高纯硅精密零部件、氮化铝陶瓷材料和零部件几大核心方向进行建设。
项目总投资金额	52,000.00万元
投资建设周期	3年

2、项目必要性分析

（1）保障国内半导体产业链供应链安全，落实国家自主可控战略

当前，集成电路产业先进制程非金属核心零部件本土供给能力仍不足，部分高精密耗材、功能性陶瓷零部件仍依赖境外厂商供给。受外部环境持续收紧影响，海外厂商在设备维保、零部件供货、技术服务等方面存在显著的不确定性，供应链中断风险直接威胁国内先进制程产线的稳定量产。

随着国内头部晶圆制造基地产能持续扩容，产线对高精密零部件耗材的需求量同步激增，必须同步培育规模化本土零部件配套产能，以强化国内供应链纵深，降低对境外来源供给的依赖。本次通过武汉臻宝新建“半导体零部件研发生产基地项目”可大幅提升高精密零部件本土供给规模，有效填充高

● 募投项目实施周期：根据重庆臻宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行并上市相关规划，公司募投项目拟分三至四年投入。

● 阶段性现金管理方案：不超过人民币100,000万元（含本数），该额度是闲置募集资金（含超募资金）阶段性现金管理上限金额，随着募集资金按计划投入募投项目建设，募集资金现金管理金额会相应减少。

● 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。

● 已履行的审议程序：公司于2026年8月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确同意的核查意见。

● 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金使用计划及募集资金投资项目情况

根据《重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.32	75,185.06
2	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	28,166.56
3	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	16,400.68
合计		128,336.42	119,752.30

（一）半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目

本项目总投资81,061.32万元，其中拟使用募集资金投入金额为75,185.06万元，各项具体投资金额及比例如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金额
1	工程建设费用	75,834.53	69,958.27
1.1	土地购置费	3,640.02	3,640.02
1.2	场地建造及装修费	19,606.14	15,165.65
1.3	软硬件购置	52,588.37	51,152.60
2	基本预备费2%	1,516.69	1,516.69
3	铺底流动资金	3,710.10	3,710.10
合计		81,061.32	75,185.06

本项目拟在重庆市开展相关工作。项目建设期为4年，项目开展将按照土地购置、场地建造及装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和投入生产进度来安排，具体如下表：

注：T代表项目开始时点

截至本公告出具日，公司于2022年6月30日与重庆西彭工业园区管委会、重庆铝产业开发投资集团有限公司签署《重庆臻宝实业有限公司半导体新材料研发制造项目投资协议》。公司已陆续完成部分厂区的建设及装修，同步开展生产设备采购与安装调试工作；三期生产基地A厂区已正式投入使用，B厂区建设装修工作稳步推进。项目建成后，将进一步扩充公司精密零部件加工及表面处理产能。

（二）臻宝科技研发中心建设项目

本项目总投资30,274.42万元，其中拟使用募集资金投入金额为28,166.56万元，各项具体投资金额及比例如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金额
1	工程建设费用	18,508.50	16,400.64
1.1	土地购置费	384.00	384.00
1.2	场地建造费及装修费	4,329.00	4,329.00
1.3	软硬件购置费用	13,795.50	11,687.64
2	研发费用	11,172.31	11,172.31
2.1	研发人员工资	5,969.31	5,969.31
2.2	其他研发费用	5,203.00	5,203.00
3	基本预备费2%	593.61	593.61
合计		30,274.42	28,166.56

本项目拟在重庆市开展相关工作。项目建设期为3年，项目开展将按照土地购置及建造装修、设备购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进度来安排，具体如下表：

注：T代表项目开始时点

截至本公告出具日，公司已完成部分研发方向的项目立项、设备进场与安装调试及人员配置；半导体刻蚀设备用静电卡盘、特殊涂层材料及涂层技术等研发项目正处于关键研发攻坚阶段。

（三）上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目

本项目总投资17,000.68万元，其中拟使用募集资金投入金额为16,400.68万元，各项具体投资金额及比例如下：

单位：人民币/万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金
1	工程建设费用	9,143.66	8,543.66
1.1	场地租赁费	318.66	318.66
1.2	场地装修费	600.00	0.00
1.3	软硬件购置费	8,225.00	8,225.00
2	研发费用	7,523.68	7,523.68
2.1	研发人员工资	3,845.68	3,845.68
2.2	其他研发费用	3,678.00	3,678.00
3	基本预备费2%	333.34	333.34
合计		17,000.68	16,400.68

本项目拟在上海市开展相关工作。项目建设期为3年，项目开展将按照场地租赁、场地装修、软硬件购置安装及调试、人员调配及培训和产品技术研发进度来安排，具体如下表：

注：T代表项目开始时点

截至本公告出具日，公司已完成上海研发中心场地租赁及装修工作。ESC静电卡盘高精密加工与掩膜喷砂技术、TCP Windows特殊涂层、氮化铝加热盘等研发方向已完成立项，同步开展研发设备采购、安装调试及人员配置，相关项目已步入关键研发攻坚阶段。

二、闲置募集资金进行阶段性现金管理方案概述

（一）现金管理目的

根据公司募投项目整体实施进度规划，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。为优化资金管理、提升短期财务收益，公司将科学合理地对闲置募集资金进行阶段性现金管理，提高募集资金使用效率，不影响公司募投项目的正常进行。

（二）现金管理金额

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募资金）进行阶段性现金管理，募集资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。

（三）现金管理资金来源

本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票的募集资金。公司拟使用募集资金不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金（含本次公开发行超募资金）进行现金管理，具体资金来源如下：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕499号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,882.2600万股，每股发行价格为人民币44.56元，募集资金总额为人民币172,993.51万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,516.43万元后，实际募集资金净额为人民币160,477.08万元。

公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投入金额的部分为超募资金，超募资金为40,724.78万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2026年6月18日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕8-5号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（四）现金管理方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、收益凭证、国债逆回购、货币基金等），可按募投项目资金需求随时赎回或支取，提前赎回或支取仅损失一定收益。该类现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，且产品期限不超过一年。

2、实施方式

现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。董事会授权公司经营管理层在上述有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择符合资格机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或者协议、开立或者注销产品专用结算账户等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

3、收益分配方式

募集资金现金管理所获收益归公司所有并视同募集资金进行专项管理。公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金的监管要求管理和使用募